



## Intel® Core™ i7-5775C Processor

6M Cache, up to 3.70 GHz

### Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i7 piątej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Broadwell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Desktop
- Numer procesora i7-5775C
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q2'15
- Litografia 14 nm
- Rekomendowana cena klienta \$366.00 - \$377.00

### Wydajność

- Liczba rdzeni 4
- Liczba wątków 8
- Bazowa częstotliwość procesora 3,30 GHz
- Maks. częstotliwość turbo 3,70 GHz
- Cache 6 MB
- Szybkość magistrali 5 GT/s DMI2
- TDP 65 W
- Konfigurowalna częstotliwość TDP-down 2,20 GHz
- Konfigurowalny tryb TDP-down 37 W

### Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

### Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 32 GB
- Rodzaje pamięci DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

### Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® Iris™ Pro Graphics 6200
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 300 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,15 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 32 GB

- eDRAM 128 MB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) ‡ 4096x2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP) ‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz) ‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA) ‡ 1920x1200@60Hz
- Obsługa DirectX\* 11.2
- Obsługa OpenGL\* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI) Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Technologia Intel® Clear Video Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy ‡ 3
- Identyfikator urządzenia 0x1622

## Opcje rozszerzeń

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express ‡ Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

## Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCLGA1150
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCA 2013D
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm

## Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost ‡ 2.0
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy ‡ Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading ‡ Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) ‡ Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) ‡ Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ Tak
- Intel® TSX-NI Tak
- Intel® 64 ‡ Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Technologia bezprzewodowa 4G WiMAX Nie
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Intel® Virtualization Technology for Itanium® (VT-i) Nie
- Technologia Intel® ochrony tożsamości ‡ Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Nie

## Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak

- Secure Key Tak
- Intel® OS Guard Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak
- Technologia Anti-Theft Tak